

チップレット開発推進

AI演算処理に特化

エッジ人工知能（AI）半導体を開発するエッジコーティックス（東京都中央区、サキャシシガ・タスクプロダ最高経営責任者〈CEO〉）は、AIの演算処理に特化した新たな半導体チップの開発に乗り出す。従来単一のチップに集積していたものを複数チップに個別化し相互接続する「チップレット」を採用した新型の半導体で、2025年以降の実用化を見据える。ロボット向けなどでの採用を目指す。

エッジコーティックスは、消費電力が8ワットは24年から、処理能力は60TOPS（毎秒）のAIモデルに対応

60兆回の命令処理能力を持った半導体「SAKURA-2」の量産を始める方針。

エッジコーティックス



エッジコーティックスは、高性能なAI処理を行える半導体を手がける（LLMなどに対応したサクラ2）

今回新たに開発するのは、チップレットを採用することで性能を向上させ、処理できるパラメータの規模をSAKURA2より大きくする方針。大規模言語モデル（LLM）などに対応する。今後より大きなAIモデルの登場を先取りし、新型半導体の開発を進める。

同社は中央演算処理装置（CPU）や画像処理半導体（GPU）のような汎用用途では

なく、端末で生成AIを動かすためのソフトウェアと、そのソフトウェアを動かすのに最適化された半導体を手がける。これにより消費電力を抑えながら、LLMなどの基盤モデルを端末側で実装できるようになる。サキャシシガCEOは「米国や日本、韓国などの地域で、さまざまなビジネスの分野でAIアクセラレーターが伸びている」と、新型の半導体開発に力を入れる。

同社は理化学研究所や日本IBMなどに在籍したサキャシシガCEOが立ち上げたスタートアップ。SBインベストメント（東京都港区）やルネサスエレクトロニクスなどから出資を受ける。